



<b>Title of Change:</b>	Split from FPCN23098Z: besides change lead frame inner plating from Silver + Copper to only copper, additionally change from Hitachi to Hysol mold compound, for SC88 parts at Leshan, China	
<b>Proposed Changed Material First Ship Date:</b>	30 Dec 2021 or earlier if approved by customer	
<b>Current Material Last Order Date:</b>	24 Sep 2021 <i>Orders received after the Current Material Last Order Date expiration are to be considered as orders for new changed material as described in this PCN. Orders for current (unchanged) material after this date will be per mutual agreement and current material inventory availability.</i>	
<b>Current Material Last Delivery Date:</b>	29 Dec 2021 <i>The Current Material Last Delivery Date may be subject to change based on build and depletion of the current (unchanged) material inventory</i>	
<b>Product Category:</b>	Active components – Discrete components	
<b>Contact information:</b>	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <a href="mailto:York.Yu@onsemi.com">York.Yu@onsemi.com</a>	
<b>PCN Samples Contact:</b>	Contact your local ON Semiconductor Sales Office to place sample order or <a href="mailto:PCN.samples@onsemi.com">&lt;PCN.samples@onsemi.com&gt;</a> . Sample requests are to be submitted no later than 45 days after publication of this change notification. Samples delivery timing will be subject to request date, sample quantity and special customer packing/label requirements.	
<b>Sample Availability Date:</b>	16 Jul 2021	
<b>PPAP Availability Date:</b>	30 Sep 2021	
<b>Additional Reliability Data:</b>	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <a href="mailto:c.l.yang@lps.com.cn">c.l.yang@lps.com.cn</a>	
<b>Type of Notification:</b>	This is a Final Product/Process Change Notification (FPCN) sent to customers. The change will be implemented at 'Proposed Change Material First Ship Date' in compliance to J-STD-46 or ZVEI, or earlier upon customer approval, or per our signed agreements. ON Semiconductor will consider this proposed change and it's conditions acceptable, unless an inquiry is made in writing within 45 days of delivery of this notice. To do so, contact <a href="mailto:PCN.Support@onsemi.com">PCN.Support@onsemi.com</a> .	
<b>Change Category</b>		
<b>Category</b>	<b>Type of Change</b>	
Process - Assembly	Change of mold compound, Change of lead frame finishing material / area (internal)	
<b>Description and Purpose:</b>		
This Split FPCN is issued since: besides lead frame inner plating changing, there's an additional changing of mold compound for affected device in this split FPCN, see details in below table.		
Purpose of the changing is to unify mass production BOM(Bill Of Material) .		
Reliability Qualification and electrical characterization data can be provided upon customer request		
	<b>Before Change Description</b>	<b>After Change Description</b>
LeadFrame	Inner Silver+Copper plated lead frame	Inner Copper plated lead frame
Mold Compound	Hitachi GE-200F	Hysol GR640 HV
There is no product marking change		



<b>Reason / Motivation for Change:</b>	Source/Supply/Capacity Changes Process/Materials Change	
<b>Anticipated impact on fit, form, function, reliability, product safety or manufacturability:</b>	<p>The device has been qualified and validated based on the same Product Specification. The device has successfully passed the qualification tests. Potential impacts can be identified, but due to testing performed by ON Semiconductor in relation to the PCN, associated risks are verified and excluded.</p> <p>No anticipated impacts.</p>	
<b>Sites Affected:</b>		
<b>ON Semiconductor Sites</b>		<b>External Foundry/Subcon Sites</b>
Leshan Phoenix Semiconductor, China		None
<b>Marking of Parts/ Traceability of Change:</b>	Products (listed on this PCN) assembled with the Cu plated lead frame in ON Semiconductor facility, Leshan, China, will have a Finish Good Date Code from about Week 52, 2021 or earlier	
<b>Reliability Data Summary:</b>  <b>NOTE: AEC-1pager is attached.</b> <i>To view attachments:</i> 1. Download pdf copy of the PCN to your computer 2. Open the downloaded pdf copy of the PCN 3. Click on the paper clip icon available on the menu provided in the left/bottom portion of the screen to reveal the Attachment field 4. Then click on the attached file		
<b>Electrical Characteristics Summary:</b>  Electrical characteristics are not impacted, data can be provided upon customer request.		
<b>List of Affected Parts:</b>  <b>Note:</b> Only the standard (off the shelf) part numbers are listed in the parts list. Any custom parts affected by this PCN are shown in the customer specific PCN addendum in the PCN email notification, or on the <b><u>PCN Customized Portal</u></b> .		
<b>Current Part Number</b>	<b>New Part Number</b>	<b>Qualification Vehicle</b>
NVJS3151PT1G	NA	NVJS3151PT1G

Japanese translation of the notification starts here.  
通知の日本語訳はここから始まります。

**Note:** *The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.*

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。



## 最終製品 / プロセス変更通知

文書番号# : FPCN23098ZA

発行日: 23 Jun 2021

変更件名:	FPCN23098Z からの分離: リードフレームの内部メッキの銀+銅から銅のみへの変更に加え、樂山 (中国) の SC88 部品のモールドコンパウンドの Hitachi から Hysol への変更	
初回出荷予定日:	2021 年 12 月 30 日 またはお客様からの承認が得られた場合はそれ以前	
現在の材料の最終注文日:	2021 年 9 月 24 日 既存品の最終注文日以降の注文は、この PCN に記載されている変更後品の注文とみなされます。この日付より後の既存品(変更前品)の注文は、相互契約により変更前品の在庫状況に応じて履行されます。	
現在の材料の最終出荷日:	2021 年 12 月 29 日 既存品 (変更前品) の最終出荷日は、変更前品の製造および在庫の状況によって変更されることがあります。	
製品カテゴリ:	アクティブなコンポーネント – ディスクリットコンポーネント	
連絡先情報:	現地のオン・セミコンダクター営業所または < <a href="mailto:York.Yu@onsemi.com">York.Yu@onsemi.com</a> > にお問い合わせください。	
サンプル:	サンプルの注文または< <a href="mailto:PCN.samples@onsemi.com">PCN.samples@onsemi.com</a> >を注文するには、お近くの ON Semiconductor 営業所 にお問い合わせください。 サンプルのリクエストは、この変更通知の公開後 45 日以内に提出してください。 サンプルの納品時期は、リクエスト日、サンプル数量、特別なお客様の梱包/ラベルの要件に従います。	
サンプル提供開始可能日:	2021 年 7 月 16 日	
PPAP 提供開始日:	2021 年 9 月 30 日	
追加の信頼性データ:	お客さまの地域のオン・セミコンダクター営業所または< <a href="mailto:c.l.yang@lps.com.cn">c.l.yang@lps.com.cn</a> >にお問い合わせください。	
通知種別:	これは、お客様宛の最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) です。 この変更は、「変更後の材料の初回出荷予定日」に J-STD-46 または ZVEI に準拠して実施されるか、お客様からの承認が得られた場合はそれ以前に、あるいは署名された契約書ごとに実施されます。 オン・セミコンダクターは、この通知の送付から 45 日以内に書面による問い合わせが行われない限り、この変更およびその条件が受諾されたものとみなします。 お問い合わせは、 <a href="mailto:PCN.Support@onsemi.com">PCN.Support@onsemi.com</a> お願いします。	
変更カテゴリ:		
Category	変更種別	
処理 – アセンブリ	モールド材の変更 リードフレーム仕上げ材料 / エリア(内部)の変更	
説明および目的:		
この FPCN の分離理由: リードフレームの内部メッキの変更に加え、この FPCN 分離の影響を受けるデバイスのモールドコンパウンドの追加の変更があるため。詳細は以下の表をご覧ください。		
変更の目的は大量生産の BOM (部品表) を統合することです。		
信頼性認証および電気特性のデータはお客様のご要望に応じて提供できます		
	変更前の表記	変更後の表記
リードフレーム	Inner Silver+Copper plated lead frame	Inner Copper plated lead frame
モールド・コンパウンド	Hitachi GE-200F	Hysol GR640 HV
今回の変更に伴う製品表示の変更はありません。		



## 最終製品 / プロセス変更通知

文書番号# : FPCN23098ZA

発行日: 23 Jun 2021

変更の理由 / 動機:	ソース/供給/能力変更 プロセス/材料変更	
適合性、形状、機能、信頼性、製品安全性、または製造可能性に関して見込まれる影響	デバイスは同じ製品仕様に基づいて認定および検証されています。デバイスは認定試験に正常に合格しています。潜在的な影響が確認される可能性があります、オン・セミコンダクターが PCN に関して実施する検査により、関連するリスクは検証および排除されています。  予想される影響はありません。	
影響を受ける拠点:		
オン・セミコンダクター拠点:	外部製造工場 / 下請業者拠点:	
Leshan Phoenix Semiconductor, China	無し	
部品の表示 / 変更の追跡可能性:	梁山 (中国) のオン・セミコンダクター施設において銅メッキリードフレームで組み立てられる製品 (本 PCN に記載) は、2021 年第 52 営業週以降のデータコードが付けられます	
信頼性データの要約:		
添付文書を見るには: 1. ご使用のコンピューターに PDF 版の PCN をダウンロードします。 2. ダウンロードした PDF 版の PCN を開きます。 3. 添付欄を見るには、画面左 / 下部分のメニュー上にあるクリップアイコンをクリックしてください。 4. 添付ファイルををクリックします		
電気的特性の要約:		
電気的特性への影響はありません。データはお客様のご要望に応じて提供できます。		
影響を受ける部品の一覧:		
注: 標準の部品番号 (既製品) のみが部品一覧に記載されます。 本 PCN に影響を受けるカスタム 部品は、PCN メールの顧客の特定の PCN の付属文書、または PCN カスタマイズポータルに記載されています。		
現在の部品番号	新部品番号	認定試験用ピークル
NVJS3151PT1G	NA	NVJS3151PT1G